

关键指标

频率: 2~4GHz
增益: 29.5dB
噪声系数: 0.6dB
1dB 压缩点输出功率: 11dBm
工作电压: +5V
工作电流: 28mA
芯片尺寸: 1.8mm×1.2mm×0.1mm

产品简介

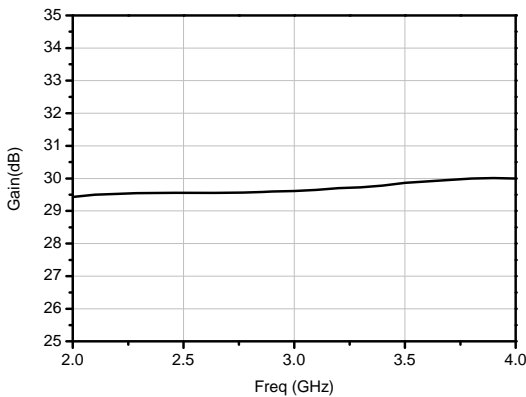
HG113FC-2/HG113FC-2(M)是一款 2~4GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 29.5dB, 1dB 压缩点输出功率为 11dBm, 噪声系数为 0.5dB。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+5V)

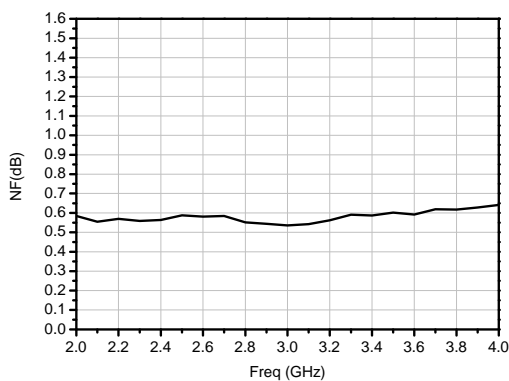
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~4		
增益(dB)	—	29.5	—
增益平坦度(dB)	—	±0.8	—
输入驻波	—	1.4	—
输出驻波	—	1.3	—
噪声系数(dB)	—	0.6	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	11	—

典型测试曲线

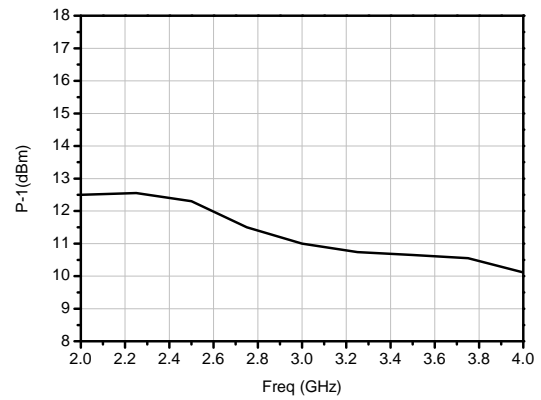
增益



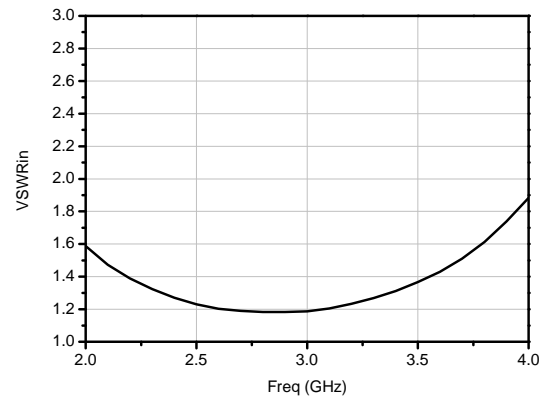
噪声系数



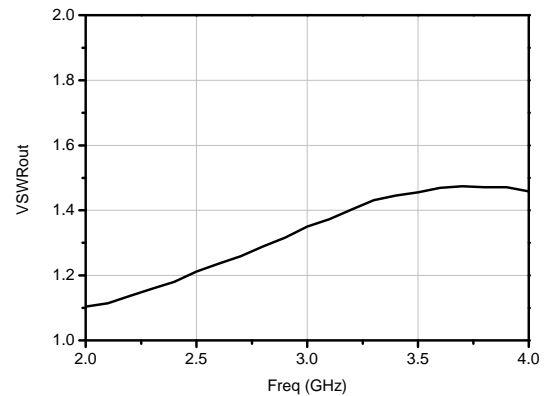
1dB 压缩点输出功率



输入驻波



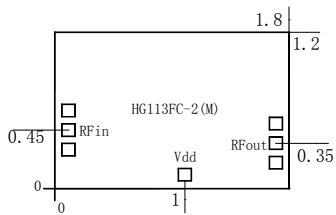
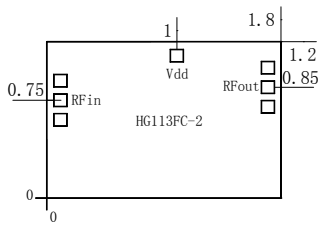
输出驻波



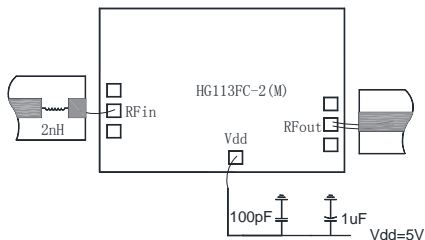
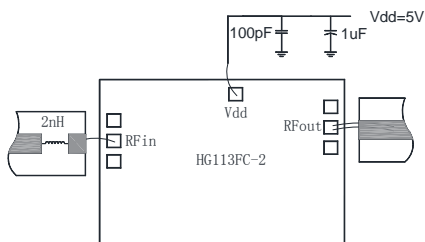
绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。